

圧電材料・デバイス シンポジウム 2024

日 時：**2024年1月29日（月）～30日（火）**
会 場：東北大学 サイエンスキャンパスホール
主 催：圧電材料・デバイスシンポジウム実行委員会
共 催：弾性波素子技術コンソーシアム
ホームページ：<https://pmds.yamanashi-u.jp/PoPM-Dsymposium/>

講演申込*：**2023年12月5日（火）締切**
講演題目、著者名、所属、連絡先メールアドレス等を以下のフォームから申し込みください。
講演申込先：<https://forms.gle/5FsWzZq3KwQo4Dss7>
*お申込みいただいた講演の採否は、締切後にこちらからご連絡いたします。採択となりました場合には、次の要領で予稿原稿をご提出ください。

予稿原稿：**2024年1月9日（火）締切**
原稿見本の様式(ホームページに掲載)で A4 版 2 ページ、4 ページ、または 6 ページ (最終的には白黒で B5 版に縮小印刷します)とし、PDF ファイルに変換の上、ご提出をお願いします。
提出方法**は講演採択のご連絡とともにお伝えいたします。
**本年より学会が準備する web フォルダ(dropbox)上へのアップロード提出を予定しています。

参加費：一般：調整中 学生およびシニア***：調整中
弾性波素子技術コンソーシアム産業界会員の企業様は1名まで無料
***定年退職後、企業や研究機関に所属しておらず、また、コンサルティング業等を行っていらっしゃらない方

参加申込：**2024年1月22日(月)ー 2024年1月12日（金）締切**
参加申込み、参加費支払の方法は調整中です。

懇親会：1/29（月）講演終了後に開催を予定しています。場所、金額等は調整中です。

連絡先：講演申込、テクニカルプログラム、予稿原稿等について
原 基揚（情報通信研究機構）
Tel：042-327-5476 E-mail: hara.motoaki@nict.go.jp
参加費、参加登録、スポンサーシップ等について
相原 友子（東北大学・田中(秀)研究室）
Tel: 022-795-6934 E-mail: aihara@tohoku.ac.jp